公司代码:688603　　公司简称:天承科技

广东天承科技股份有限公司

【2024】年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在本报告中描述可能存在的风险,敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分,请投资者注意投资风险。

3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

1、公司拟向全体股东按每10股派发现金红利3元(含税)。截至2025年3月31日,公司总股本为83,957,192股,扣除公司回购专用证券账户中股份数758,556股后的股本数为83,198,636股,以此计算合计拟派发现金红利24,959,591元(含税)。本年度公司现金分红总额为24,959,591元(含税);本年度以现金为对价,采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为37,773,122.82元(不含印花税、交易佣金等交易费用),现金分红和回购金额合计62,732,713.82元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例84.00%。其中,以现金为对价,采用集中竞价方式回购股份并注销的回购(以下简称回购并注销)金额为0元,现金分红和回购并注销金额合计24,959,591元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例33.42%。

2、公司拟向全体股东以资本公积金每10股转增4.9股。截至2025年3月31日,公司总股本为83,957,192股,扣除公司回购专用证券账户中股份数758,556股后的股本数为83,198,636股,以此计算合计拟转增40,767,332股,本次转增完成后,公司总股本为124,724,524股。

3、公司通过回购专用账户所持有本公司股份758,556股,不参与本次利润分配及资本公积金转增股本。如在本议案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持现金派发每股分配比例和每股转增比例不变,相应调整现金派发总额及转增总额,并将另行公告具体调整情况。

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	天承科技	688603	不适用

1.2公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表	证券事务代表
姓名	费维	邹碧骏	苏志钦
联系地址	上海市青浦区诸光路1588弄虹桥世界中心L2-B栋806室	上海市青浦区诸光路1588弄虹桥世界中心L2-B栋806室	上海市青浦区诸光路1588弄虹桥世界中心L2-B栋806室
电话	021-59766069	021-59766069	021-59766069
传真	021-59766069	021-59766069	021-59766069
电子信箱	wei.fei@skychemcn.com	rongjun.zou@skychemcn.com	zhiqin.su@skychemcn.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1主要业务、主要产品或服务情况

1、主要业务

公司主要从事印制线路板、封装载板和半导体先进封装所需要的专用功能性湿电子化学品的研发、生产和销售。随着制造技术发展进步和下游应用领域拓广,新工艺、新结构和新材料的引入进一步对功能性湿电子化学品提出了更新、更高的要求。通过不断自主创新研发,公司产品的应用类型由普通的印制线路板发展至高频高速、高密度互连(HDI)、软硬结合、类载板(SLP)等高端印制线路板;同时扩展到FC-CSP/BGA封装载板及半导体先进封装以及显示面板等领域。公司一直专注于化学沉积、电化学沉积及界面处理技术,研发团队深耕相关行业技术三十余年,现已掌握了前述高端印制线路板、封装载板、半导体先进封装等相关的产品制备及应用等多项核心技术。公司紧抓产业升级和国际化的新机遇,不断探索前沿工艺的融合发展,持续创新提升核心竞争力,打破行业垄断并持续提供创新的技术方案。

2、主要产品及用途

公司聚焦专用功能性湿电子化学品,公司主要产品包括化学沉铜专用化学品、电镀专用化学品、铜面处理专用化学品、先进封装专用化学品及其他专用化学品等,覆盖化学沉铜、电镀铜、电镀镍、电镀锡、棕化、粗化、退膜、闪蚀、化学沉锡等多个生产环节。其中化学沉铜和电镀铜工艺是电子电路制程中重要的环节,是实现电气互连的基础,直接影响电子设备的可靠性。

公司专用功能性湿电子化学品按照下游应用的制程工艺分为以下几类:

(1)化学沉铜专用化学品

化学沉铜是电子电路生产过程中重要的环节,系通过化学方法在不导电的介电材料表面沉积一层薄薄的导电铜层,为后续电镀铜提供导电种子层,是多层板之间电气互连的关键工艺流程。高质量的化学沉铜的效果是印制线路板、封装载板等导电性能的重要保证,进而保障了电路以及电子设备的可靠性。

随着品质、技术和环保需求的驱动,中国大陆印制线路板厂商逐步采用水平沉铜工艺替代垂直沉铜工艺。与此同时,水平沉铜专用化学品成为沉铜制程使用的主流材料。

公司的水平沉铜专用化学品于2012年成功推向市场,经过十余年的发展,公司持续改善产品,目前已经发展出四大水平沉铜产品系列,能满足市场上不同电路板的生产需求。主要用于高端印制线路板、封装载板的生产。

封装载板是芯片封装体的重要组成材料,主要作用为承载保护芯片以及连接上层芯片和下层电路板。针对新高端IC载板ABF膜如GL102和国产载板增层材料的特性,公司开发了兼容性更强的除胶剂、调整剂和低应力化学沉铜液等产品,随着公司载板沉铜专用化学品在材料兼容性和产品性能等方面的提升,公司在载板领域新开拓了华进半导体封装先导技术研发中心有限公司、江阴芯智联电子科技有限公司等客户。

产品系列	产品特点	适用产品	目前主要客户
SkyCopp365	1、盲孔处理能力强,可处理盲孔纵横比(孔径50-125微米)为1:1;2、适用现行的高频高速基材;3、单剂稳定剂,便于客户现场管控	适用于多层板、高频高速板、HDI、类载板、半导体测试板等	方正科技、崇达技术、景旺电子、信泰电子、博敏电子、广合科技、兴森科技等
SkyCopp365SP	1、盲孔处理能力强,可处理盲孔纵横比(孔径50-125微米)为1:1-1:1.5;2、互联可靠性高,特定测试板严酷可靠性测试下(光铆Ref low 30次)内层连接测试与国际厂商同等水平。	适用于多层板、高频高速板、HDI、类载板、半导体测试板等	深南电路、胜宏科技、超毅电子、方正科技、世运电子、生益电子、景旺电子、中京电子等
SkyCopp3651	产品不含镍,节能环保(市场上的水平沉铜药水一般含400ppm的镍离子)	适用于要求沉铜废水中不含镍的生产企业	定颖电子、博敏电子、兴森科技、景旺电子、崇达技术等
SkyCopp3652	材料兼容性广泛,是一款低应力高贯孔能力产品,适用PI和BT材料	适用多层软板、软硬结合板以及载板	景旺电子、世一电子、宏悦兴等

(2)电镀专用化学品

电子电路在经过化学沉铜工艺之后,孔壁和铜面(SAP工艺后)上沉积上一层0.2-1微米的薄铜,使得不导电的孔壁产生了导电性,但是铜层的厚度还达不到电子元件信号传输和机械强度需要的厚度。导通孔通常要求孔内铜厚达到20微米以上,因此需要用电镀的方法把铜层加厚到需要的厚度。此外,高密度互连(HDI)、类载板等还要求盲孔完全填满铜以改善电气性能和导热性,有助于高频设计,便于设计叠孔和益上孔,减少孔内空洞,降低传输信号损失,最终实现产品功能及质量的提高。

随着电子产业发展,高端印制线路板的孔纵横比越来越大,线宽线距变得越来越小,对电镀铜工艺的挑战也越来越高。随着线宽线距变得越来越小,传统电镀工艺使用的可溶性阳极在电镀过程中会因为溶解消耗导致尺寸形状发生变化,影响电流分布,进而影响铜镀层在电路板表面上的均匀性;随着通孔厚径比的增大,电镀工艺的深镀能力也需要进一步提升。

根据以上行业需求,公司对适用于不溶性阳极电镀、脉冲电镀的电镀添加剂技术进行研发,并开发出了以下主要产品系列、主要用于高端印制线路板、封装载板等的生产:

产品系列	主要特点	适用产品	目前主要应用客户
SkyPlateCu658	1、适用不溶性阳极电镀,解决阳极保养问题,并减少铜成本;2、应用于水平线脉冲填孔,对盲孔填孔有显著优势;3、电镀速度快,完成填孔所需的面铜厚度低	适用于HDI、类载板电镀	超毅、方正科技等
SkyPlateVF6382	1、可应用在VCP或者龙门电镀设备,设备兼容性高;2、兼容可溶性阳极和不溶性析氧阳极,可应用于不溶性阳极直流填孔,填孔性能稳定;3、兼容通孔盲孔共镀	适用于HDI电镀	定颖电子、博敏电子、南亚电路、中京电子等
SkyPlateCu6257	1、适用不溶性阳极VCP脉冲电镀,采用纯铜溶铜块技术,解决阳极保养问题,并减少铜成本;2、适用于通孔电镀,深镀能力好;3、镀层结晶均匀,应力低,延展性好,抗拉强度优良;4、相对于传统电镀,能应用较大的电流密度,提升产能。	适用于消费类电子产品、车板等	景旺电子等

(3)铜面处理专用化学品

电子电路制造过程中需要对铜面进行贴膜、阻焊等工序,在这些工序之前,一般需要对铜面进行特殊处理,主要系通过改变铜表面形貌或化学成分以增强与树脂材料的结合力。

公司根据不同工序和不同电子电路对铜面处理的要求,开发出以下产品,主要用于高端印制线路板、封装载板、显示屏等的生产:

产品类别	应用环节	适用产品	主要客户
超粗化产品	防焊前处理	HDI、汽车板	奥特斯、定颖电子、方正科技、华通电脑、华通精密、景旺电子等
中粗化产品	防焊前处理;压膜前处理	5G通讯板、HDI	定颖电子、南亚电路、安泰诺等
再生微蚀产品	内层线路压膜前处理	通用大部分印刷线路板	明阳电路、中富电子等
碱性微蚀产品	表面处理	柔性电路板	景旺电子、精诚达、鹏鼎控股等

a、超粗化产品主要应用于防焊前处理,电路板的表面需要覆盖一层防焊油墨以防止焊接时短路,其中涉及铜与防焊油墨的结合,铜面必须经过适当处理,才会与防焊油墨有足够的结合力满足电路板的可靠性要求。公司产品处理前后的对比图如下:

b、超粗化技术虽能满足铜与防焊油墨的结合力要求,但其粗糙度过高,不能满足5G等高频高速应用对信号完整性的要求。公司开发的中粗化产品,通过在铜面产生不规则蚀刻,在低微蚀量下使比表面积增加30-60%,同时能够控制表面峰谷之间的落差不至于过大,不仅可以满足5G信号对PIM值要求,还可以应用于贴膜前处理。公司产品处理前后的对比图如下:

c、微蚀产品用于内层线路贴膜前处理,主要作用为对铜面进行处理使其与干膜/湿膜有足够的结合力,传统的微蚀技术需要频繁换槽和添加大量的蚀刻液,并产生大量废水。公司的再生微蚀产品利用三价铁离子对铜面进行微蚀,三价铁离子变成二价铁离子,然后利用电解的方法将二价铁离子转化回三价铁离子,同时铜离子被还原成纯铜回收,槽液循环利用、无废液排放,有利于清洁生产。生产中还可以通过调节电解电流启动控制三价铁离子的浓度从而实现稳定的微蚀速率,降低了综合生产成本。公司产品处理前后的对比图如下:

d、一般电子电路可以采用酸性微蚀产品进行表面处理,但对于某些特殊的材料,不适合采用酸性微蚀产品进行表面处理。如软板在做OSP时(有机可焊性保护剂,表面处理的一种方法),酸性微蚀药水对镀镍铜片的镍层存在一定程度的腐蚀,导致OSP后铜片发白,造成批量性的报废。公司开发出碱性微蚀产品,在碱性环境下对铜面微蚀清洁,不会腐蚀镀镍铜片镍层。

(4)半导体先进封装专用化学品

随着AI技术迅猛发展,极大增加了相关产业对高性能算力的需求,先进封装成为推动半导体发展的关键力量之一,公司围绕2.5D/3D先进封装、扇出型封装、玻璃基板等领域需求积极研发,目前公司已完成硅通孔(TSV)电镀铜、再布线层(RDL)电镀铜、凸点(bumping)电镀铜/镍/锡银和玻璃基板通孔TGV金属化等工艺所需电镀液产品的研发和技术储备,不断实现关键技术突破与产品应用,提速半导体制造关键材料及技术突破。

a、硅通孔(TSV)电镀产品主要应用于2.5D/3D封装,产品对小孔和高纵深比结构有优异的填充能力、具备面铜镀层薄、退火后表面凸起小、镀层杂质含量低、镀层应力低,延展性高和抗拉强度大等优点。其主要效果图如下:

硅通孔(TSV)是HBM工艺中的核心工艺,其中TSV填孔镀铜是最核心、最难的工艺,对添加剂和设备的要求较高。随着TSV工艺趋向小孔径、高密度、大深宽比,制造过程容易产生内部温度、应力失配等问题,进而产生底部空洞、内部缝隙、填充缺失等典型缺陷,将会影响TSV工艺良率及成本。公司研发硅通孔电镀添加剂产品可对标国际品牌,目前正全力为头部客户提供技术领先的解决方案。

b、再布线层电镀铜产品主要应用于扇出型封装,产品具备优异的填孔和细线路能力,具有整片均匀性优异较低的镀层应力,高延展性和抗拉强度等优点。其主要效果图如下:

c、凸点电镀铜产品主要应用于倒装芯片封装,产品适用于高速电镀场景,电流密度可达20ASD、同时具备优异的高度均匀性和共面性、镀层杂质含量低、较低的镀层应力、高延展性和抗拉强度等优点。其主要效果图如下:

d、TGV电镀产品主要应用于先进封装中以玻璃基板为介质的孔电镀,产品适用于脉冲和直流电镀,具备填孔性能优异、较低的镀层应力、高延展性和抗拉强度、电镀后无晶体缺陷等优点。其主要效果图如下:

公司在半导体封装领域的硅通孔电镀铜、再布线层电镀铜和凸点电镀系列产品得到了知名封装厂的肯定,性能达到国际先进水平。顺应高性能计算和人工智能的发展趋势,公司迅速投入玻璃基板通孔TGV金属化技术的研发,并已获得产业链的广泛认可。同时公司与顶级OEM企业建立了深入合作关系,共同推动产业化进程。此外,公司同步研发大马士革工艺、混合键合工艺等相关添加剂产品和应用技术,目前正努力推广中。

(5)其他专用化学品

公司的专用功能性湿电子化学品还包括触摸屏专用电子化学品、化学沉锡专用化学品、光阻去除剂、棕化专用化学品等,分别主要应用于金属网格沉铜工序、封装载板化学沉锡工序、退膜工序、棕化工序,目前在江苏软讯、南亚电路、景旺电子、奥特斯、信泰电子等知名电子电路厂商已量产应用。

2.2主要经营模式

1、研发模式

公司主要服务于高端印制线路板、半导体及显示面板等行业,电子类产品技术发展更新迭代较快,对于专用电子化学品的需求也不断变化。为应对相关行业技术的不断更新,解决客户的诉求,及时为市场提供匹配新技术、新材料、新工艺的优质产品,公司始终重视研发工作,拥有独立的研发部门和研发团队,将研发工作作为公司发展的重要支撑。

公司研发模式为自主研发,立足于自主研发、自主创新,拥有一套独立完善的研发体系。公司研发工作由研发中心负责,下设技术委员会、平台研发和产品研发。公司已形成了完善的研发流程,研发方向以行业技术发展和应用需求为基础,研发内容主要包括新产品和技术研发以及现有产品的持续优化。

公司产品的研发主要包括两个阶段:

(1)实验室研发测试阶段

公司研发人员通过对应用材料特性、基础化学品性质的研究,对基础配方进行设计、选材和配比,从烧杯测试到中试线的反复验证,形成功能性湿电子化学品的基础配方。

(2)产线技术开发阶段

为公司选择合适的具有代表性的客户产线进行技术开发,并针对不同客户生产线实际情况,如喷流压力、喷流量、喷流角度、负载量等以及复杂多样的材料及电子电路产品结构设计(比如孔大小、密度、分布等),对配方进行进一步验证和优化,并匹配最合适的应用参数的范围,包括各个工序中电子化学品的浓度、配比、温度、压力等,最终确电子化学品的标准配方及相配套的工艺应用参数。

2、采购模式

公司以“源头采购与向经销商采购相结合”的方式进行原材料的采购,对于贵金属等金额较大、使用量较大的原材料公司主要向生产厂家采购;使用量不大的原材料主要通过经销商采购。

公司制定了严格的供应商选择程序。公司通常选择行业内具有较高知名度的供应商进行合作,对于有合作意向的供应商,公司会进一步对其经营资质、生产能力、质量及稳定性、工艺水平、供货及时性、价格等多方面进行评估;评估通过后方可纳入供应商名录,建立采购合作关系。

对于确认合作关系的供应商,公司进行跟踪管理,对供应商交货及时性及品质合格率进行评价,对于评价不合格的供应商,公司将进行降级处理,减少或者停止向该供应商采购产品。

3、生产模式

公司采用“以销定产、订单驱动、合理库存、合理排产”的生产模式,专用功能性湿电子化学品在下游厂商生产过程中属于耗用稳定的产品,生产部门结合客户的订单以及市场部门的销售预测利用ERP系统中的MRP功能自动制定生产计划,根据生产计划自动下发生产任务并开展生产作业。

4、销售模式

公司主要采取直销的销售方式,经销的比例较低。公司和客户的销售结算方式主要包括包线销售和单价销售。公司根据客户的生产工艺需求,提出解决方案,并制定产品组合方案,同时,公司委派技术服务工程师到客户生产线进行技术支持等相关售后服务,必要时由技术委员会的技术专家提供问题解决方案和支持。

2.3所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1)行业发展阶段

功能性湿电子化学品系电子电路、半导体先进封装生产制作中的必备原材料,电子电路、半导体先进封装的生产制造过程中的化学沉积、电化学沉积、界面处理等众多关键工序均需要使用大量专用电子化学品。根据Prismark2024年第四季度报告统计2024年以美元计价的全球PCB产业产值同比增长5.8%,全球封装基板预计销售额同比增长0.8%,其中18层及以上多层板、HDI增速明显高于行业水平,主要得益于算力、高速网络通信和新能源汽车及ADAS等下游领域呈高景气,带动PCB产业相关产品需求保持较高增长。在宏观经济温和复苏。在行业库存周期性回补的背景下,高端PCB板、封装基板等产品的需求缓慢修复。中长期层面,PCB产业延续高频高速、高精密度、高集成化等发展趋势,18层及以上的高多层板、HDI板、封装基板未来五年复合增速预计保持相对较高水平。从区域分布看未来五年全球各区域PCB产业仍呈增长态势其中,中国大陆地区复合增长率为4.3%。

国内功能性湿电子化学品行业起步较晚,国内企业起初主要通过技术难度较低的洗槽剂、消泡剂、蚀刻、剥膜、褪锡等产品进入市场,后续逐步开发棕化、沉铜、电镀、化学镍金等重要工艺所用的功能性湿电子化学品。在普通PCB双面板和多层板专用电子化学品方面,国内厂商占有一定的市场份额。对于高频高速板、HDI、软硬结合板、类载板、半导体测试板、载板、半导体等高端PCB、半导体先进封装使用的功能性湿电子化学品,国内整体的技术水平相比国际先进水平还有一定差距。由于功能性湿电子化学品的性能高低能够在一定程度上决定高端PCB、半导体先进封装产品在集成性、导通性、信号传输等特性和功能上的优劣,因此高端PCB、半导体先进封装厂商对于功能性湿电子化学品供应的选择较为谨慎,其中沉铜和电镀添加剂尤为明显,因此高端PCB、半导体先进封装专用功能性湿电子化学品长时间被欧美、日本等地品牌所占领。

随着中国大陆电子电路产业的发展壮大和国产化替代的需求扩大,近几年来中国大陆电子电路功能性湿电子化学品企业持续加大对研发的投入,建立研发中心,同时招聘高水平技术人才,生产技术水平得到了有效的提升。同时,部分企业针对下游厂商的需求进行定制化开发,实现对产品配方创新和改良,将产品打入下游厂商,逐渐打破外资企业对高端PCB、半导体先进封装专用功能性湿电子化学品的垄断。

(2)行业基本特点

国外功能性湿电子化学品发展起步较早,国际知名功能性湿电子化学品制造商掌握研发的核心技术,品牌知名度高,市场占有率高,具备较强的先发优势。我国功能性湿电子化学品发展起步较晚,国内企业在生产规模、技术和品牌等方面竞争力较弱,高端功能性湿电子化学品国产化需求十分迫切。当前,在全球集成电路、人工智能、大算力、新能源汽车等产业产能加速向中国转移的背景下,从产品交期、供应链保障、成本管控及技术支持等多方面考虑,原材料进口替代的需求十分强烈,境内功能性湿电子化学品企业迎来了重大的发展机遇。

(3)行业主要技术门槛

电子电路功能性湿电子化学品行业具有较高的技术门槛,具体体现为以下方面:

①专业综合性较强:电子电路专用电子化学品的配方设计和调整系材料学、电化学、有机化学、物理、化工工艺等多个学科知识的综合应用,需要技术专家对行业技术有敏锐判断,并经过多次反复测试才能将形成成熟的产品。

②下游技术需求较复杂:电子电路的种类较多,相应对专用电子化学品提出不同的技术需求。特别对于高端PCB(含封装载板)和半导体先进封装,近年来高端PCB材料种类和型号不断增加,包括各类高频高速基材、软板PI膜、载板的ABF材料和BT材料等,因此需要根据材料的特性开发出兼容性更高的专用电子化学品。与此同时,高端PCB产品结构的升级对专用电子化学品也提出新的技术需求,比如高多层设计的通孔纵横比不断提高,对专用电子化学品的灌孔能力提出更高的要求;多阶盲孔和任意层互联的结构设计,对专用电子化学品在盲孔的润湿性提出更高的要求。因此高端PCB使用的专用电子化学品配方开发具有更高的技术壁垒。

③功能性湿电子化学品在实际应用中,应用工艺的参数比如药水浓度、药水搭配组合、生产设备运行参数(如运行速率、温度,泵频率)等影响电子化学品的应用效果,行业内企业需要经过长时间的应用积累才能形成成熟的应用经验,从而形成较高的技术与经验壁垒。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

由于功能性湿电子化学品领域具有较高的技术门槛,因此高端电子电路板制造使用的专用功能性湿电子化学品长期被安美特、陶氏杜邦、麦德美乐思和JCU等国际巨头所垄断。受中美贸易摩擦等因素影响,国内高科技企业积极推动上游供应链核心原材料“国产化”,以实现“自主可控”,保障自身产业链安全。国内企业转向国产核心原材料促使上游供应链企业加强技术研发,不断改革创新,加快国产化进程步伐,这也为国内专用电子化学品企业提供了良好的发展机遇。

公司作为一家专业从事专用功能性湿电子化学品研发及产业化的高新技术企业,通过近三十年的研究发展,在产业升级和国际化新机遇的背景下,天承科技将凭借自身的研发、产品、服务、口碑等优势进一步提升销售规模与市场份额,持续探索前沿工艺的融合发展,致力于成为一家国内功能性湿电子化学品的领军企业。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

报告期内,公司研发并推出了半导体先进封装相关的功能性湿电子化学品,其中,TSV、RDL、bumping、TGV等部分先进封装电镀添加剂等产品已推向下游测试验证,获得了知名封装厂的肯定,性能达到国际先进水平。公司于2023年8月31日披露了投资建设集成电路功能性湿电子化学品电镀添加剂系列技改项目的新项目,旨在建设半导体集成电路领域电子化学品的生产基地。公司目前正将大力推动相关先进封装电镀液及晶圆级电镀液投向市场的进度。

当前,在全球集成电路、人工智能、大算力、新能源汽车等产业加速发展、加速竞争的背景下,从产品交期、供应链保障、成本管控及技术支持等多方面考虑,原材料进口替代的需求十分强烈,境内功能性湿电子化学品企业迎来了重大的发展机遇。公司作为一家积累了近三十年并专注于高端功能性湿电子化学品研发及产业化的高新技术企业,不断开发高端产品将有助于打破国外巨头在相关领域的垄断,填补国内相关材料技术空白,加速国产替代,增强我国高端功能性湿电子化学品的全球竞争力。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	1,242,601,122.09	1,170,731,269.42	6.14	395,332,835.29
归属于上市公司股东的净资产	1,121,806,995.89	1,097,127,653.75	2.25	326,830,574.87
营业收入	380,670,972.91	338,928,877.29	12.32	374,363,998.77
归属于上市公司股东的净利润	74,679,913.48	58,572,302.56	27.50	54,612,013.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	62,111,324.27	54,890,351.60	13.16	53,609,850.18
经营活动产生的现金流量净额	71,096,999.52	62,164,790.39	14.37	72,612,133.61
加权平均净资产收益率(%)	6.80	8.23	减少1.43个百分点	18.40
基本每股收益(元/股)	0.89	0.79	12.66	1.26
稀释每股收益(元/股)	0.89	0.79	12.66	1.26
研发投入占营业收入的比例(%)	7.35	6.60	增加0.75个百分点	5.91

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	80,088,379.16	92,688,286.15	100,340,869.91	107,553,437.69
归属于上市公司股东的净利润	17,940,505.85	18,711,709.38	20,513,106.40	17,514,591.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	15,185,862.44	15,492,848.00	18,304,186.90	13,128,426.93
经营活动产生的现金流量净额	33,734,966.00	48,919,211.05	-5,373,794.47	-6,183,383.06

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	2,200
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	2,814
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
天承化工有限公司	0	9,658,110	16.61	9,658,110	无	0	境外法人
上海道添电子科技有限公司	0	9,462,222	16.28	9,462,222	无	0	境内非国有法人
童茂军	60,545	8,566,847	14.74	8,566,847	无	0	境内自然人
上海青骐企业管理合伙企业(有限合伙)	0	6,492,976	11.17	6,492,976	无	0	其他
上海青珣电子科技合伙企业(有限合伙)	-753,689	1,883,911	3.24	1,660,495	无	0	其他
深圳市前海睿兴投资管理有限公司-宁波市睿兴二期股权投资合伙企业(有限合伙)	-801,122	1,747,270	3.01	0	无	0	其他
青岛祝融富田投资管理有限公司-祝融富田三期私募投资基金	未知	919,412	1.58	0	无	0	其他
青岛祝融富田投资管理有限公司-祝融昂芒18号私募证券投资基金	未知	811,147	1.40	0	无	0	其他
民生证券投资有限公司	0	726,711	1.25	726,711	无	0	境内非国有法人
中芯聚源私募基金管理(天津)合伙企业(有限合伙)-聚源中小企业发展创业投资基金(绍兴)合伙企业(有限合伙)	-581,369	585,298	1.01	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述的前十名股东中:股东上海道添电子有限公司为实际控制人童茂军控制的企业,除此以外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内的公司主要经营情况详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”部分。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688603　　证券简称:天承科技　　公告编号:2025-010

广东天承科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东天承科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议通知于2025年4月4日以邮件形式送达全体董事,本次会议于2025年4月9日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长童茂军先生召集并主持召开,会议应出席董事6人,实际出席董事6人,公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)及《广东天承科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决,审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》

2024年,公司管理层在董事会带领下,严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求,忠实勤勉地履行自身职责,坚决贯彻执行股东会、董事会的各项决议并完成2024年度各项工作,各项业务整体达到了预期目标,且保持了稳健的趋势

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案无需提交公司股东会审议。

(二)审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

2024年度,董事会本着对全体股东负责的态度,积极有效地开展工作,切实履行股东会赋予的职权,严格执行股东会决议,积极推进董事会决议的实施,持续完善公司治理结构,确保董事会科学决策和规范运作,不断提升公司规范运作能力,推动公司持续稳定发展,维护公司和股东的合法权益。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年度董事会工作报告》。

(三)审议通过《关于2024年度独立董事述职报告的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年度独立董事述职报告》。

(四)审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

经董事会核查,独立董事杨振国先生、蒋薇薇女士、石建宾先生的任职经历以及签署的相关自查文件,确认上述人员2024年度未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东单位担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,符合《上市公司独立董事管理办法》及《科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

(五)审议通过《关于2024年度董事会审计委员会履职报告的议案》

董事会认为,2024年度,董事会审计委员会勤勉尽责地履行审计委员会的职责和义务,审慎认真地行使公司、股东和董事会所赋予的权利,对公司董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年度董事会审计委员会履职报告》。

(六)审议通过《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告的议案》

董事会认为,北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)在公司年报审计过程中勤勉尽责,遵循独立、客观、公正的原则执行审计,表现出良好的职业素养和专业胜任能力,按时高质量完成了公司年报审计工作,出具的审计报告客观、完整、清晰。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年度会计师事务所的履职情况评估报告》

(七)审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

董事会认为,董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《公司章程》等有关规定,充分发挥专门委员会的作用,对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查。审计委员会在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通,督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

(八)审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

董事会认为,公司2024年度财务报表已经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的《审计报告》。公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况,以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年度财务决算报告》。

(九)审议通过《关于2025年度财务预算报告的议案》

董事会认为,公司2025年度财务预算报告是在对2025年宏观经济环境、国家产业政策、行业发展趋势等各方面信息综合分析判断的基础上,结合2024年公司实际经营数据和2025年公司经营计划进行测算并编制,符合公司生产经营、研